

FICHA TÉCNICA

BROPASTE ELECTRONIC - ECO 5

Pasta de soldadura SMD - ECO 5, libre de haluros, No-Clean. Para una amplia gama de aplicaciones y diseños de PCB, de acuerdo con la aleación 501 UNE-EN ISO 9453.

DATOS TÉCNICOS

| PROPIEDADES | | |
|-----------------------|--|--------------------|
| Apariencia | Pasta gris sin cuerpos ni elementos visibles | |
| Composición Aleación | ECO 5 - Sn/Ag0.3/Cu0.7 | JIS-Z-3282 |
| Punto de fusión | 217-227 °C | |
| Tamaño Partícula | (T 4) +38µm <1%, -20µm <10% | IPC-TM-650, 2.2.14 |
| Forma de la partícula | Esférica | |
| Contenido de Flux | 11.5 ± 1.0% | JIS-Z-3197, 8.1.2 |
| Contenido de haluros | < 0.0 wt.% (en flux) | J-STD-004 |
| Viscosidad | 200 ± 30 Pa·s (25±1°C, 10 rpm, Malcom) | JIS-Z-3284 Annex 6 |
| Tipo de Flux | ROLO | J-STD-004 |

PROPIEDADES ECO 5 (Aleación 501)

| Elemento | Composición (ECO 5) |
|----------------|---------------------|
| Estaño (Sn) | Rem. |
| Plata (Ag) | 0.2-0.4 |
| Cobre (Cu) | 0,5-0,9 |
| Antimonio (Sb) | 0,10 |
| Bismuto (Bi) | 0,06 |
| Oro (Au) | 0,05 |
| Plomo (Pb) | 0,07 |
| Indium (In) | 0,10 |
| Aluminio (Al) | 0,001 |
| Arsenico (As) | 0,03 |
| Cadmio (Cd) | 0,002 |
| Hierro (Fe) | 0,02 |
| Niquel (Ni) | 0,01 |
| Zinc (Zn) | 0,001 |

Para obtener más datos técnicos de nuestros alloys por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Fecha de revisión: 26/02/2020

FICHA TÉCNICA

BROPASTE ELECTRONIC - ECO 5

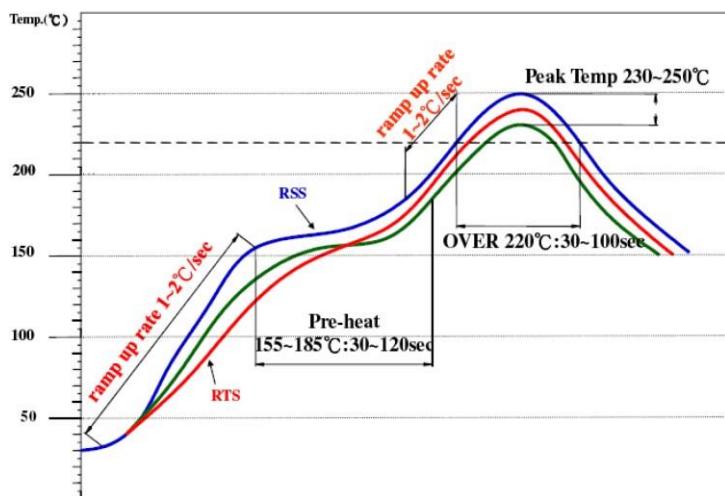
RENDIMIENTO Y FIABILIDAD

| TESTS DE | | |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Corrosión de la placa de cobre | Pass | JIS-Z-3197, 8.4.1 |
| Difusión | >70% | JIS-Z-3197, 8.3.1.1 |
| Cromatografía iónica | 0.0 wt.% | IPC-TM-650 Method 2.3.28.1 |
| espejo de cobre | Pass | IPC-TM-650, 2.3.32 |
| Viscosidad (25°C, 10 rpm) | 200 ± 30 Pa·s | JIS-Z-3284, Annex 6 |
| Pegajosidad (gf) | >130 (8hr.) | JIS-Z-3284, Annex 9 |
| Asentamiento o caida | Pass | JIS-Z-3284, Annex 7, 8 |
| Bola de soldadura | Pass | JIS-Z-3284, Annex 11 |
| S.I.R * Resistencia de aislamiento | > 1x10 ⁹ Ω, Pass | IPC-TM-650, 2.6.3.3 |
| Migración eléctrica ** | Pass | IPC-TM-650, 2.6.14.1 |

*Conditions test : 85°C RH durante 168 hrs.

**Condiciones test: 65°C, 88.5% RH durante 596 hrs.

PERFIL DE REFLUJO RECOMENDADO



- Tasa de Aceleración (Ramp Up rate): (30-150°C) 1.0-2.0°C/seg
- Tiempo de Pre-Calentamiento (Pre-heating Time): (155-185°C): 30-120 seg.
- Periodo de tiempo por encima de (Time period above of) : 220 °C: 30-100 Seg.
- Aumento durante el Reflujo (Ramp Up During Reflow) : 1.0-2.0°C/seg.
- Punta Máxima Temperatura (peak Temp) 240-250°C
- Rampa Temperatura Descenso (Ramp Down Rate): 1.0-6.0°C/seg.

Fecha de revisión: 26/02/2020



FICHA TÉCNICA

BROPASTE ELECTRONIC - ECO 5

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

- Refrigerar la pasta de soldadura de 0-10°C. La vida útil es de 6 meses a partir de la fecha de producción.
- Mantenga alejado de la luz solar directa.
- Permita que la pasta alcance la temperatura de impresión definida (temperatura ambiente) durante 3-4 horas. No caliente la pasta de soldadura rápidamente.
- Para el embalaje en tarro, mezcle la pasta de soldadura antes de usarla durante 1-3 minutos con espátula de plástico.
- Se recomienda terminar la pasta fresca dentro de las 24 horas. No mezclar pasta usada y la pasta fresca nueva en el mismo frasco.
- Si el proceso de impresión se interrumpió durante más de una hora, retire la pasta restante de la plantilla y cerrar el frasco.
- Temperatura de entorno de impresión recomendada. 22-28°C y HR 30-60%

FORMATOS

| Aleación Soldadura (501) | Flux | Tamaño Partícula | Envase |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------|
| ECO 5(SnAg0.3Cu0.7) | ROLO | T4 – 20-38 µm | 50 g. Jeringa 500 g. Tarro |

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios técnicos y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la gran variedad de materiales y condiciones de trabajo en las que se utilizan nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o los daños causados por mal uso.

Fecha de revisión: 26/02/2020